

会場案内図

2016年6月1日(水)～3日(金)
東京ビッグサイト 東2～6ホール

第12回JPCA賞(アワード)受賞企業

JPCA 2016 Show
第46回国際電子回路産業展
主催：一般社団法人電子回路産業協会
協賛：PC/Electronics Packaging and Circuits Association

JIEP 2016
マイクロエレクトロニクス
第30回最先端実装技術・パッケージング展
主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会(JIEP)
協賛：Japan Institute of Electronics Packaging

JISSO PROTEC 2016
第18回実装プロセステクノロジー展
主催：一般社団法人日本電子回路工業会
協賛：JEP, Japan Robot Association (JARA)

ラージエレクトロニクスショー2016
Co-Sponsored by:
JPCA (Japan Electronics Packaging and Circuits Association)
Electronic Device Industry News (Shogei Times, Inc.)

WIRE Japan Show 2016
無線・ケーブル・コネクタ総合技術展
主催：一般社団法人日本電子回路工業会、電子情報技術産業協会

Mektec
日本メカトロニクス株式会社
5D-04

orbotech
The Language of Electronics
3B-04

FPCコネクト
FPC connection co.,ltd.
6C-11

Meltex
Link to X
2B-12

MacDermid Enthone
ELECTRONICS SOLUTIONS
2A-12

アシアと日本をつなぐビジネスHUB
沖縄県
沖縄ブースにぜひどうぞ!
3F-21

出展者・セミナー検索、詳細情報はWebから!
フリーワード、展示会、製品カテゴリだけでなく、利用応用分野や課題を解決するための展示技術など様々な項目で検索いただけます。気になる展示・セミナーを効率よく、お探しください。

JPCA賞(アワード)受賞者

第12回JPCA賞
■設備状態監視のキーデバイスを担うプリント基板プロセスで実現した高感度エネルギーセンサ 株式会社デンソー 【小間番号：5E-04】
■超薄FPCビルドアップ用フレキシブル樹脂付き銅箔 FeliosFRCC [R-FR10] パナソニック株式会社 【小間番号：2D-24】
■L/S=2/2μmの超微細回路形成および最終表面処理プロセス トップUFFPプロセス 奥野製薬工業株式会社 【小間番号：2C-24】
■低伝送損失基板を実現する低誘電率・高接着ポリイミド樹脂 [PIAD] 荒川化学工業株式会社 【小間番号：4C-28】
■次世代高周波対応新規低伝送損失・低熱膨張多層材料 MCL-HS100 日立化成株式会社 【小間番号：2D-12】
■最新の蛍光X線膜厚計による膜厚測定と微細パターンを持つ電子回路基板への適用 株式会社日立ハイテクサイエンス 【小間番号：5E-08】

JPCA奨励賞

■環境対応・高機能型(ほう素フリースルファミン酸ニッケルめっき薬品) 日本化学産業株式会社 【小間番号：2B-07】
■熱設計のパラダイムシフトに対応するために KOA株式会社 【小間番号：5B-16】

～福島を応援～「日本橋ふくしま館」福島物産コーナー
【小間番号：5G-08】
ままだおる、喜多方ラーメン、家伝ゆべしなど
ふくしま名物・お土産 販売中!!

熊本地震義援金 受付中
東2・5ホール会場入口/基調講演会場
ご協力いただいた義援金は、主催者より震災復興支援の為、熊本県に寄付いたします。皆様のご協力をお願いいたします。

JPCA Show 2017 2017マイクロエレクトロニクスショー JISSO PROTEC 2017
ラージエレクトロニクスショー2017 WIRE Japan Show 2017

次回開催 2017.6.7 (Wed.) -9 (Fri.) 東京ビッグサイト 東4-8ホール
次回出展仮申込を 6A-24にてご案内中!



